## 특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허 Patent Number 제 10-1793563 호

출원번호 Application Number 제 10-2012-7019231 호

출원일 Filing Date 2012년 07월 20일

등록일 Registration Date 2017년 10월 30일

발명의 명칭 Title of the Invention

IC 유닛 결합을 위한 어셈블리 및 방법

특허권자 Patentee

록코 시스템즈 피티이 리미티드 싱가포르 417869 싱가포르 카키 부키트 로드 2 61

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

## 위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual Property Office 2017년 10월 30일

특허청장

COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

4

N

3

(Translation)

## LETTERS PATENT

PATENT NO.:

10-1793563

APPLICATION NO.:

10-2012-7019231

FILING DATE OF KOREAN TRANSLATION:

July 20, 2012

**REGISTRATION DATE:** 

October 30, 2017

TITLE:

ASSEMBLY AND METHOD FOR IC UNIT ENGAGEMENT

PATENTEE:

**ROKKO SYSTEMS PTE LTD** 

61 Kaki Bukit Road 2, Singapore 417869, Singapore

INVENTOR:

YANG, Hae Choon

JUNG, Jong Jae JANG, Deok Chun LIM, Chong Chen Gary

This is to certify that the above patent has been duly registered on the Patent Register under the Patent Act.

October 30, 2017

The Commissioner of the Korean Intellectual Property Office